

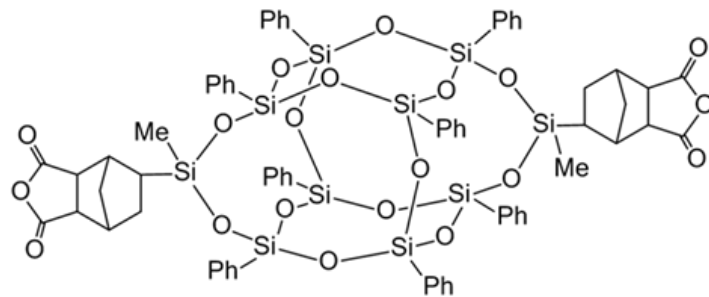
ダブルデッカー型シルセスキオキサンおよびこれを用いた 低誘電・高耐熱樹脂に関するJNCとのライセンス契約締結について

日本材料技研株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 浦田 興優、以下「日本材料技研」）は、このたび、JNC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 山田 敬三、以下「JNC」）との間で、ダブルデッカー型シルセスキオキサンおよびこれを用いた低誘電・高耐熱樹脂に関し、ライセンス契約を締結しましたのでお知らせいたします。

ライセンス対象は、JNCグループが独自に開発したダブルデッカー型シルセスキオキサンを基本構造とするモノマー（以下「本モノマー」）およびこれを用いたポリイミド樹脂やエポキシ樹脂などです。シルセスキオキサンは低誘電性や高耐熱性など多くの優れた特性を持つケイ素化合物で、特にダブルデッカー型シルセスキオキサンは剛直な多面体構造を持ち、より高耐熱で優れた機械強度を示すポリマーへの応用が期待されています。一方で、シルセスキオキサンの合成は技術的に難しい上に、既存のシルセスキオキサン誘導体は、樹脂添加剤かシルセスキオキサンを側鎖に含むポリマーしかなく、シルセスキオキサン本来の特性を十分に付与できていませんでした。本モノマーは二官能性であるため、ポリマーの主鎖にかご型シルセスキオキサンを組み込むことができ、低誘電・高耐熱なポリイミド樹脂やエポキシ樹脂の開発につながることを期待されます。

日本材料技研では、JNCから本モノマーに関するライセンスを受け、主にポリイミド樹脂メーカーやエポキシ樹脂メーカーに対してモノマーを供給することで、ディスプレイ分野や光エレクトロニクス分野で用いられる新たな低誘電・高耐熱樹脂の開発を目指します。

<本モノマーの一例>



日本材料技研では、これまでにBNFO系負熱膨張材や高耐熱エポキシ合成触媒の技術導入を進めており、エレクトロニクス分野において大きな課題となっている熱マネジメントに関する機能性材料の事業化に積極的に取り組んでいます。5G（第五世代移動通信システム）の運用開始を控え、低誘電、低線熱膨張、高耐熱などの熱マネジメントに関するニーズが急速に拡大・多様化する中、革新的な熱マネジメント材料の工業化を進め、エレクトロニクス製品のイノベーションに貢献することを目指します。

日本材料技研は、有機材料・無機材料・バイオケミカル等の素材分野に特化したファブレス型ベンチャーとして、国内企業や大学・研究機関等で開発された革新的技術について、ライセンスアウトやカーブアウトを通じた事業化に取り組んでいます。今後も、企業が開発した未事業化技術の商業化を進めることで、日本の素材産業におけるイノベーション創出に貢献してまいります。

以上